

天津金海通半导体设备股份有限公司
关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会战略委员会第三次会议、于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”的内部投资结构。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元（不含税）后，募集资金净额为 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金累计投入金额	投入进度	变动情况
----	------	-------	------------	------	------

1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	21,559.32	49.43%	拟调整内部投资结构
2	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	7,861.10 （注 1）	71.04% （注 2）	已终止 （注 3）
3	补充流动资金	20,000.00	20,113.00	100.57% （注 4）	
合计		74,681.19	49,533.42		

注 1：“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约 247.22 万元（前述金额系按合同计算，需根据合同实际履行情况确认，最终金额以项目实际支付为准）。

注 2：受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响，本公司“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 11 月，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。

注 3：基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。未来，公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，同时，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否追加投资。保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。

注 4：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的相关情况

（一）本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

公司“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”投资规划形成时

间较早，其可行性方案是根据当时公司的实际需求以及预计的未来发展需要做出的。近年来，随着项目建设的正式推进实施，公司根据行业技术发展持续进行产品迭代。公司三温测试分选机、大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）、以及适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台等产品，对研发实验室、试制及量产车间等的配套装修、厂务设施等方面的需求进一步提升。基于以上背景并结合公司产品升级迭代后的实际建设需要以及行业发展趋势，出于审慎考虑，公司对项目所需土建工程、采购设备及对应的资金需求进行了再梳理及统筹优化，为确保募集资金使用的高效化及规范化，公司拟调整“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”内部投资结构，募投项目投资总额不变，具体情况如下：

（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

单位：万元

序号	工程、费用名称	原计划投资额	调整后投资额	变动金额
1	土地购置	8,600.00	8,600.00	
2	土建工程	19,832.00	30,545.68	10,713.68
3	设备购置及安装	2,802.63	1,302.63	-1,500.00
4	工程建设其他费用	100.00	100.00	
5	基本预备费	1,566.73	1,566.73	
6	铺底流动资金	10,713.68	1,500	-9,213.68
合计		43,615.04	43,615.04	

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的影响

公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司结合实际情况和自身发展战略而做出的审慎决策，未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、本次调整部分募投项目内部投资结构履行的审议程序及相关意见

（一）履行的审议程序

本次调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第

十四次会议审议通过。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构是公司结合募投项目实施情况作出的审慎性决策，不会影响公司募投项目的正常实施，符合有关法律、法规的相关规定及公司发展战略的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整部分募投项目内部投资结构的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会战略委员会、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。
特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年8月29日